

ボイド低減実装

Void reduction mounting

良好な濡れ性を示すフラックスの開発で、ボイドを低減しました

The development of a flux with good wettability results in less voids

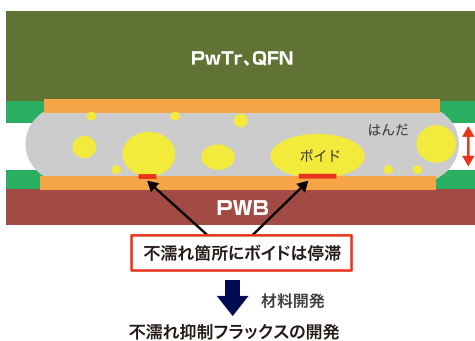
特長

- 新規フラックスGLVで、ボイド低減と経時安定性を両立
- 温度上昇が困難な大型部品でも、GLVでボイドを低減
- GLVは、M705や車載用途のM794とM758に適用



仕様

● 一般的なボイド発生解決策



工法開発

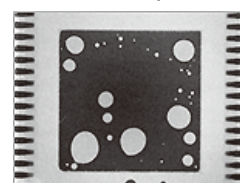
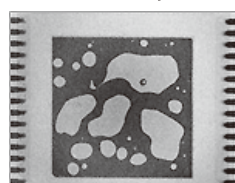
はんだ厚の検討
(クリアランス)

工法開発
プロファイルの検討

厚いはんだ膜厚は、ボイドの排出を容易とします

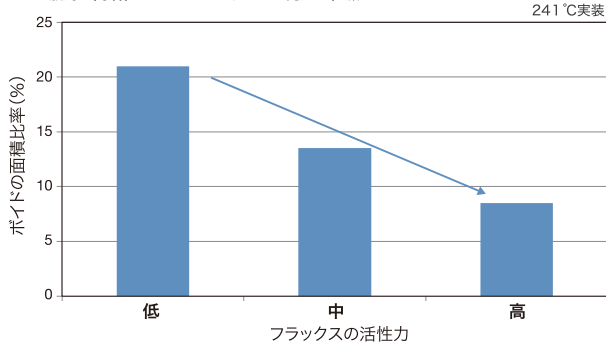
マスク厚60 μ m

マスク厚180 μ m

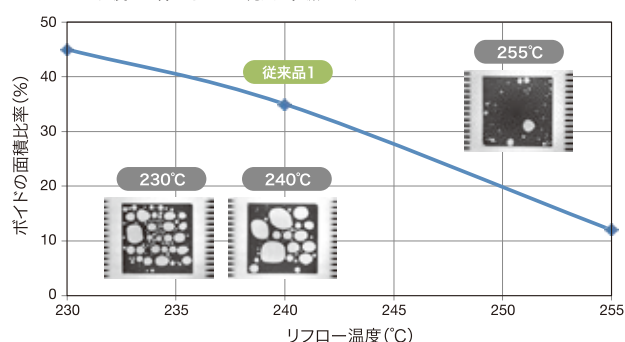


241 $^{\circ}$ C実装

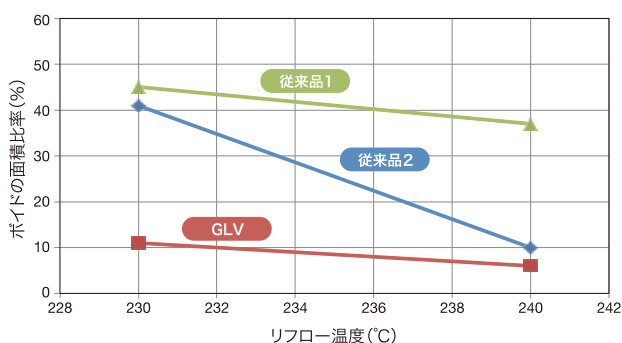
一般的に高活性フラックスはボイドの発生を低減



リフロー温度の上昇がボイドの発生を低減します

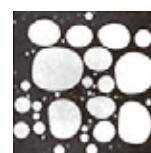


● GLVは、ボイドが停留し易い230 $^{\circ}$ Cでもボイドを抑制



230 $^{\circ}$ C

240 $^{\circ}$ C



従来品2



GLV